

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和6年9月11日(2024.9.11)

【国際公開番号】WO2022/145377

【出願番号】特願2022-573059(P2022-573059)

【国際特許分類】

C 0 8 L 1 0 1 / 1 2 (2 0 0 6 . 0 1)

C 0 8 K 5 / 3 4 1 5 (2 0 0 6 . 0 1)

C 0 8 J 5 / 2 4 (2 0 0 6 . 0 1)

B 3 2 B 1 5 / 0 8 8 (2 0 0 6 . 0 1)

B 3 2 B 1 5 / 0 8 (2 0 0 6 . 0 1)

10

【 F I 】

C 0 8 L 1 0 1 / 1 2

C 0 8 K 5 / 3 4 1 5

C 0 8 J 5 / 2 4

B 3 2 B 1 5 / 0 8 8

B 3 2 B 1 5 / 0 8 J

【手続補正書】

20

【提出日】令和6年9月3日(2024.9.3)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) 分子構造中に芳香族環と脂肪族環との縮合環を含み、N-置換マレイミド基を2個以上有するマレイミド化合物及びその誘導体からなる群から選択される1種以上と、

30

(B) 25 における引張弾性率が10GPa以下である樹脂と、

を含有し、

前記(B)成分が、(b1)側鎖にビニル基を有する共役ジエンポリマーを、(b2)N-置換マレイミド基を2個以上有するマレイミド化合物で変性してなる変性共役ジエンポリマーを含有する、樹脂組成物。

【請求項2】

(A) 分子構造中に芳香族環と脂肪族環との縮合環を含み、N-置換マレイミド基を2個以上有するマレイミド化合物及びその誘導体からなる群から選択される1種以上と、

40

(B) 25 における引張弾性率が10GPa以下である樹脂と、

を含有し、

前記(B)成分が、スチレン系エラストマーを含有する、樹脂組成物。

【請求項3】

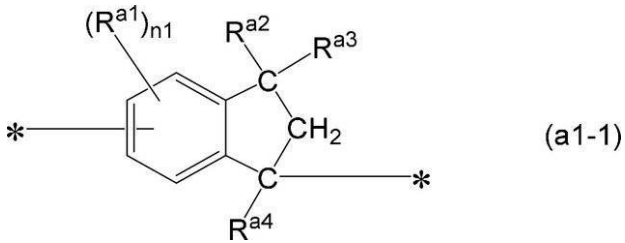
前記縮合環が、インダン環である、請求項1又は2に記載の樹脂組成物。

【請求項4】

前記インダン環が、下記一般式(a1-1)で表される2価の基として前記(A)成分に含まれる、請求項3に記載の樹脂組成物。

50

【化 1】



(式中、 R^{a1} は、炭素数1～10のアルキル基、炭素数1～10のアルキルオキシ基、炭素数1～10のアルキルチオ基、炭素数6～10のアリール基、炭素数6～10のアリールオキシ基、炭素数6～10のアリールチオ基、炭素数3～10のシクロアルキル基、ハロゲン原子、水酸基又はメルカプト基であり、 $n1$ は0～3の整数である。 R^{a2} ～ R^{a4} は、各々独立に、炭素数1～10のアルキル基である。*は結合部位を表す。)

【請求項 5】

請求項 1～4のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物又は前記樹脂組成物の半硬化物を含有するプリプレグ。

【請求項 6】

請求項 1～4のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物の硬化物又は請求項 5に記載のプリプレグの硬化物と、金属箔と、を有する積層板。

【請求項 7】

請求項 1～4のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物又は前記樹脂組成物の半硬化物を含有する樹脂フィルム。

【請求項 8】

請求項 1～4のいずれか 1 項に記載の樹脂組成物の硬化物、請求項 5に記載のプリプレグの硬化物、及び請求項 6に記載の積層板からなる群から選択される 1 種以上を有するプリント配線板。

【請求項 9】

請求項 8に記載のプリント配線板と、半導体素子と、を有する半導体パッケージ。

30

40

50